

(社)日本溶接協会 はんだ・微細接合部会
技術委員会 微細接合技術分科会 講演会
～ 低温実装材料 ～

開催日時：平成23年3月1日(火) 13:30-16:45
開催場所：社団法人 日本溶接協会 ABC会議室(8階)

【プログラム内容】

開会 座長：(株)村田製作所 高岡 英清 氏

13:30-14:05

「Sn-Bi 共晶はんだへの合金元素添加の影響」(大阪大学) 上西 啓介 氏

14:05-14:40

「高融点金属粒子添加 Sn-Bi はんだ」(旭化成イーマテリアルズ) 西嶋 純一 氏

14:40-15:00

休憩

座長：ソニー(株) 荒金 秀幸 氏

15:00-15:35

「熱硬化性はんだ接合材」(タムラ製作所) 中林 孝 氏

15:35-16:10

「Sn-Bi 系粒子-シリコン混合系による自己形成マイクロバンプ」(名古屋大学) 安田 清和 氏

16:10-16:45

「第2世代の低温鉛フリーはんだ開発」(千住金属工業) 大西 司 氏

【参加申込方法】

申込書に必要事項を記入し、郵送または FAX でお送り下さい。受付後、参加証を FAX 送付いたします。

■参加定員：定員 50名(定員になり次第締め切ります。)

■参加費用：7,000円(※資料代および消費税を含む。振込手数料は、各自ご負担下さい。)

但し、会員・大学・国公立研究機関：5,000円(ただし、学生・院生は2,000円)

(会員とは本部団体会員(<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>))

【 はんだ・微細接合部会 部会員 】※順不同

千住金属工業(株)、タムラ化研(株)、(株)ニホンゲンマ、石川金属(株)、日本アルミット(株)、(株)日本スペリア社、ニホンハンダ(株)、(株)青木メタル、内橋エステック(株)、(株)小島半田製造所、(株)弘輝、佐々木半田工業(株)、タルチンケスター(株)、(株)日本フィラーメタルズ、富士合金工業(株)、松尾ハンダ(株)、ハリマ化成(株)、山石金属(株)、三洋電機(株)、ソニー(株)、(株)東芝、(株)日立製作所、(株)富士通研究所、富士電機アドバンステクノロジー(株)、長野沖電気(株)、三菱電機(株)、トヨタ自動車(株)、(株)村田製作所、シュルンベルジェ(株)、山陽精工(株)、(株)ジャパンユニックス、白光(株)、(株)マルコム、(株)レスカ

○振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921 (社)日本溶接協会

※参加費用は上記口座へご送金下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせていただきます。また、納入された参加費は返却いたしかねますのでご了承下さい。なお、必ず振込予定日をご記入下さい。

▼お申込先：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11

(社)日本溶接協会 業務部 木口 TEL:03-3257-1524 FAX:03-3255-5196

(社) 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会 講演会 申込書
 ～低温実装材料～

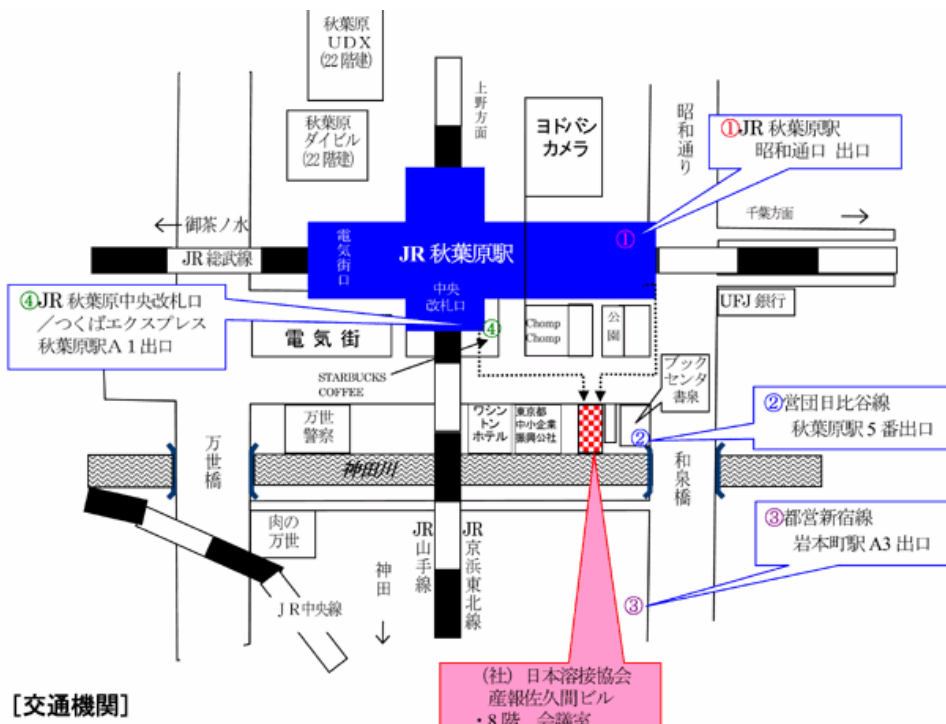
平成 年 月 日

ふりがな 氏名			
会社名/所属			
所在地	〒		
TEL		FAX(必須)	
e-mail			
振込予定日			
通信欄:			受講料 () 円

※記入頂いた個人情報は「個人情報の保護に関する法律」に則り、日本溶接協会が定めた「個人情報保護方針」に従って管理いたします。詳細につきましては、日本溶接協会ホームページ(<http://www.jwes.or.jp/>)よりご覧下さい。

会場（日本溶接協会）へのアクセス

〒104-0061 東京都千代田区神田佐久間町 1-11 TEL:03-3257-1524



【交通機関】

J R 秋葉原駅 昭和通り 徒歩 3 分

地下鉄 日比谷線 秋葉原駅 5 番出口 徒歩 1 分

地下鉄 岩本町駅 A3 出口 徒歩 4 分

つくばエクスプレス A1 出口 徒歩 3 分

【交通機関】